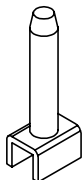
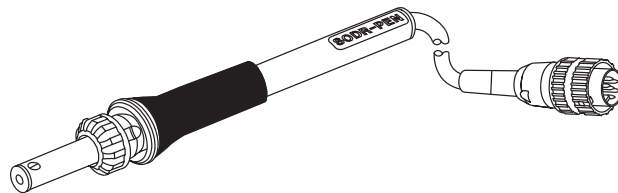


**SOIC-  
avlödningsspets**



**Sodr-Pen  
Lödpenna**



#### NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

PACE SensaTemp® Lödstation  
SP-2A Sodr-Pen® Lödpenna  
SP-2A Spets- & lödpennshållare  
SOIC Avlödningsspets  
1/16" Mejselspets  
Rengöringsdyna  
Spetsverktyg

#### PACE ARTIKELNUMMER

-----  
6025-0014-P1  
6019-0043  
Se baksida  
1121-0414  
6993-0138  
1100-0296-P1

#### TILLVALSUTRUSTNING

PACE Prep-Set™ Preparationssystem (lödgröta)

8007-0186 el.  
7041-0003  
Erhålles lokalt

Pincett

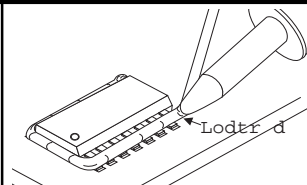
#### MATERIELL (godkänt av ert företag)

Lod  
Lösningssmedel

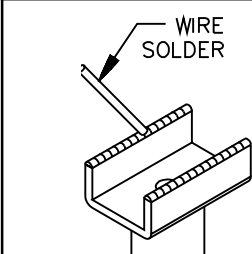
Erhålles loklat  
Erhålles lokalt

#### TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

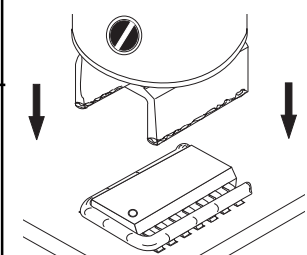
1. Avlägsna eventuell beläggning och rengör ytan från all nedsmutsning.
2. Inled med en spetsstemperatur av 315°C och anpassa sedan efter behov.
3. Installera 1/16" mejselspets i Sodr-Pen lödpenna med hjälp av spetsverktyget.
4. Löd fast lodtråd i något av komponentens hörnben och dra lodtråden i en U-form runt komponenten. Använd Sodr-Pen lödpenna med 1/16" mejselspets installerad. ①
5. Notera temperatur konstanten för den valda spetsen. (se spetsstabelle)
6. Ersätt mejselspetsen i Sodr-Pen lödpenna med SOIC-avlödningsspets.
7. Avlägsna gammalt lod från SOIC-spetsen med fiberverktyget.
8. Rengör spetsen med svampverktyget.
9. Förtenn spetsens botten och inre kanter med lod eller använd preparationsutrustningen. ②
10. Placera spetsen på komponenten. Se till att samtliga komponentens ben har kontakt med spetsen. ③ & ④
11. Kontrollera att lodet smält, i SAMTLIGA fogar, och avlägsna sedan komponenten från kortet. ④ & ⑤ (Ytspänningen som uppstår är normalt tillräcklig. Om så inte sker, är användningen av pincett ett alternativ)
12. Placera komponenten på en värmeresistent yta.
13. Förse spetsen med lod och sätt tillbaka Lödpennan i sin hållare.
14. Förbered för ersättning av komponenten.



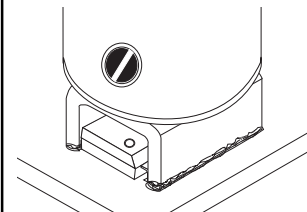
① **Tillsätt lod**



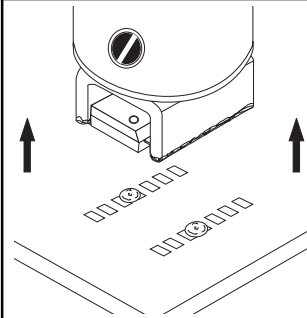
② **Förtenn spets**



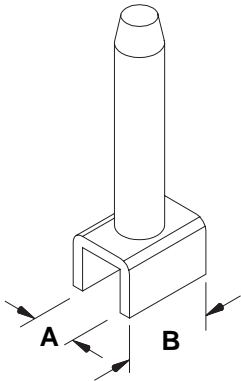
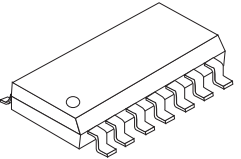
③ **Placera spets**



④ **Smält lodet**



⑤ **Avlägsna komponent**

SPETS (och applikation)	BESKRIVNING	SPETSSTORLEK A X B	ART. NUMMER	TEMPERATUR FÖRLUST	
				°C	°F
 <p><b>APPLIKATION</b></p> <p><b>SOIC</b></p> 	SOIC - 8 (JEDEC)	5.05mm x 5.08mm (0.199" x 0.200")	1121-0390	3	6
	SOIC - 8 (EIAJ)	6.25mm x 4.83mm (0.246" x 0.190")	1121-0438	3	6
	SOIC - 14 (JEDEC)	5.05mm x 8.99mm (0.199" x 0.354")	1121-0391	5	9
	SOIC - 14 (EIAJ)	5.56mm x 9.14mm (0.219" x 0.360")	1121-0377	8	14
	SOIC - 16 (JEDEC)	5.05mm x 10.2mm (0.199" x 0.404")	1121-0392	7	12
	SOIC - 16 (EIAJ)	7.42mm x 9.91mm (0.292" x 0.390")	1121-0439	8	14
	SOICL - 16 (JEDEC)	9.37mm x 10.7mm (0.369" x 0.423")	1121-0393	4	8
	SOICL - 20 (JEDEC)	9.37mm x 13.3mm (0.369" x 0.522")	1121-0394	6	11
	SOICL - 20 (EIAJ)	6.83mm x 13.0mm (0.269" x 0.510")	1121-0378	6	11
	SOICL - 24 (JEDEC)	9.37mm x 15.8mm (0.369" x 0.624")	1121-0395	9	17
	SOICL - 24 (EIAJ)	10.6mm x 15.0mm (0.416" x 0.590")	1121-0441	14	26
	SOICL - 28 (JEDEC)	9.37mm x 18.4mm (0.369" x 0.723")	1121-0396	11	20
	SOICL - 28 (EIAJ)	10.6mm x 17.5mm (0.416" x 0.690")	1121-0442	18	33